



■ **11th International Conference and Exhibition on Ceramic Interconnect and Ceramic Microsystems Technologies CICMT**

20.-23. April 2015, Fraunhofer IKTS Dresden,
Call for Papers and Posters

Die CICMT wird in 2015 erstmalig vom Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme IKTS in Dresden ausgerichtet und durch die gemeinsame Schirmherrschaft der American Ceramic Society ACerS, IMAPS Deutschland und der German Ceramic Society DKG unterstützt.

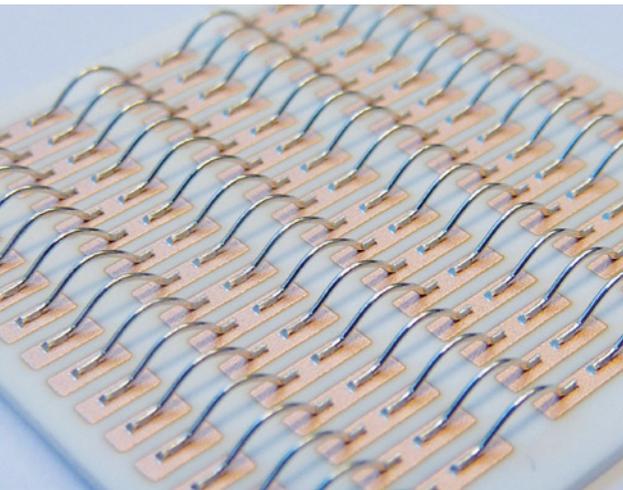
Die CICMT hat sich seit mehr als zehn Jahren als ein hochrangiges, globales Forum zur Präsentation und Diskussion der neusten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse auf dem Gebiet der keramischen Aufbau- und Verbindungs- sowie Mikrosystemtechnik etabliert. Die Themenschwerpunkte der beiden Parallelsessions liegen in den Bereichen ‚Keramische Mikrosysteme‘ und »Keramische Aufbau- und Verbindungstechnik‘.

Die Session ‚Aufbau- und Verbindungstechnik‘ fokussiert insbesondere auf kosteneffektive und zuverlässige Produkte für extreme thermische und



Bild: Fraunhofer IKTS

Dresden oder Elbflorenz in der Nacht



Dickdraht für keramische Hochleistungsmodule

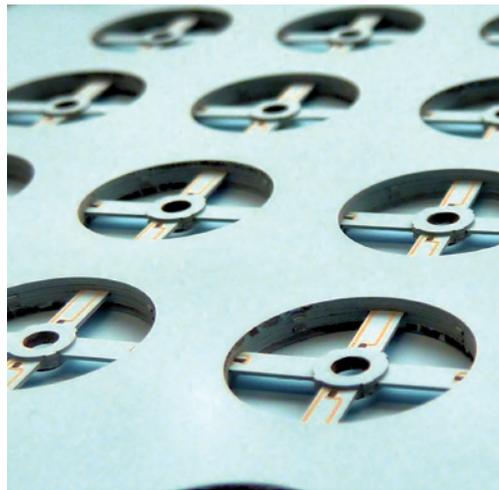


Bild: Fraunhofer IKTS

Fertigungen von Kraftsensoren im Mehrfachnutzen

chemische Umgebungen in der Automobil-, Raumfahrt-, Verteidigungs-, Sicherheits- und Kommunikationsindustrie. In der Session ‚Keramische Mikrosystemtechnik‘ stehen Zukunftsanwendungen und Produkte im Mittelpunkt, die 3D-Keramik-Strukturen zur Integration von mikrofluidischen, optischen, sensorischen und mikroreaktorischen Funktionen nutzen. Folien- und Dickschicht-Technologie, Dickschicht-Hybridtechnik, Direktschreibverfahren und generative Fertigungsverfahren werden Bestandteile beider Sessions sein, wobei sowohl die Material-, Verfahrens-, Muster- und Designentwicklung als auch die entsprechenden Anwendungsmöglichkeiten beleuchtet werden. Die Konferenz wird begleitet von einer Industrieausstellung.

Dresden – bekannt als Elbflorenz oder das Florenz des Nordens – blickt auf über 800 Jahre Geschichte zurück. Lebendiger, intellektueller Austausch ist Tradition in dieser weltberühmten Kunst- und Kulturstadt. Wissenschaftliche Kompetenz und Erfinderreichtum machten die Stadt zu einem Standort der Spitzentechnologie. Bereits seit dem frühen 18. Jahrhundert wird Dresden von einer fruchtbaren Symbiose zwischen Wirtschaft und Wissenschaft geprägt, die wichtige Erfindungen und Entwicklungen hervorbrachte. 1708 erfand hier Johann Friedrich Böttger das Verfahren zur Herstellung europäischen Porzellans. In dieser Tradition verwurzelt gilt Dresden heute als das Zentrum der Hochleistungskeramik in Europa.

Als größtes Branchennetzwerk im Bereich der Mikroelektronik und als einer der innovativsten Standorte der Informations- und Kommunikationstechnologie ist die Dresdner Region auch als ‚Silicon Saxony‘ bekannt. Die Herstellung und Entwicklung von Hochspannungsbauteilen ist hier ebenso angesiedelt wie der Maschinenbau, der in Dresden eine mehr als einhundertjährige Tradition hat. Darüber hinaus gibt es in der Stadt an der Elbe über 120 Forschungsinstitute.

Konferenz-Board

Chair: Prof. Alexander Michaelis, Fraunhofer IKTS, Deutschland

Co-Chair: Daniel Krüger, Honeywell FM&T, USA

Technical Chair: Dr. Minoru Osada, National Institute for Materials Science, Japan

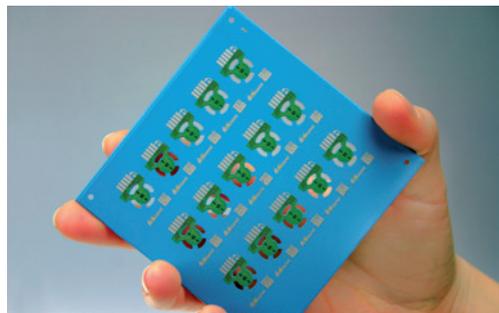


Bild: Fraunhofer IKTS

Keramischer Drucksensor in LTCC

Tab. 1: Topics

<i>Keramische Mikrosysteme</i>	<i>Aufbau- und Verbindungstechnik</i>
<p><i>Märkte und Anwendungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMS-Technologie und –Märkte - Energie und Brennstoffzellen - Biologie und Medizin - Chemie und Biochemie - Photonik <p><i>Werkstoffe und Eigenschaften</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkstoffintegration und Nanowerkstoffe - Thermisches Management und Zuverlässigkeit - Piezoelektrische Materialien - Optoelektronik <p><i>Verfahren und Fertigung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - MEMS-Fertigungstechnologien - Industrielle Automation und generative Fertigung - Nanotechnologie/Integration - Hochtemperatur-Mikrosysteme <p><i>Elemente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Sensoren und Aktoren - Mikroreaktoren - Fluidische Bauteile - Biomolekulare und Zelltransport-Systeme - Energiewandlersysteme <p><i>Charakterisierung und Zuverlässigkeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Werkstoff- und Prozesscharakterisierung - Systemzuverlässigkeit, Standzeit und Fehlerbeurteilung - Zuverlässigkeit Hochleistungs-Mikrosysteme <p><i>Auslegung, Modellierung und Simulation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Wärmeübertragung - Rechnergestützte Fluidodynamik 	<p><i>Märkte und Anwendungen</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Automotive - Luft –und Raumfahrt - Funk/Kommunikation - Medizinische Elektronik <p><i>Werkstoffe und Eigenschaften/Funktionalitäten</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Dielektrische und magnetische Materialien - Eingebettete und integrierte passive Bauteile - Mikrowellen/mm-Wellen-Charakterisierung - Keramische null-Schrumpf-Systeme <p><i>Verfahren und Fertigung</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Grünfolien-Fertigung - Mehrlagenkeramik - Lasertrimmen und -abscheiden - Dickschicht-Bearbeitung - Feinstruktur-Technologien - Generative Fertigung <p><i>Elemente</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Schaltkreise, Antennen und Filter - Eingebettete Strukturen und Komponenten - Optische Geräte und Optoelektroniken <p><i>Charakterisierung und Zuverlässigkeit</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Charakterisierung von Grünfolien - Lebensdauerprüfung und Qualitätsfragen - RF-Leistung <p><i>Auslegung, Modellierung und Simulation</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Hochfrequenz-Design-Software - Design-Regeln

Call for papers

Die Organisatoren der 11. CMCMT laden Sie herzlich ein, sich mit einem Vortrag oder Poster an der Konferenz zu beteiligen.

Einsendeschluss Abstracts: 16. November 2014

Ausführliche Informationen und Kontaktmöglichkeiten erhalten Sie unter <http://www.ikts.fraunhofer.de/> oder www.cicmt.org.

■ AmE 2015 – Automotive meets Electronics

Die 6. GMM-Fachtagung ‚Automotive meets Electronics‘ wird vom 24.- 25. 02. 2015, traditionell im

Konferenzzentrum der Westfalenhallen Dortmund stattfinden. Die Einreichungsfrist zum Call for Paper endete bereits am 8. September 2014. Die Veranstaltung bietet sowohl Fachbeiträge als auch Postersessions an. Beide Formen der Präsentation werden gleichberechtigt im Tagungsband aufgenommen.

Die Themen der letzten AmE im Februar 2014 deckten viele spannende Themenbereiche der Elektronik im Fahrzeug ab, wie Connectivity, Fahrerassistenzsysteme, Bordnetz, Entwicklungskonzepte und Diagnose.

Neben den technischen Inhalten stehen auch wieder die Begegnung gleichwertig im Mittelpunkt: For-

schung, Entwicklung und Anwendung auf der einen Seite, auf der anderen Seite Professionals, Wissenschaftler und Nachwuchs. Diese Mischung hat bisher immer zu einer regen Diskussion beigetragen, nicht nur in den Sessions, sondern auch zu allen anderen Gelegenheiten.

Es freuen sich auf ein Kennenlernen bzw. ein Wiedersehen in Dortmund Dr. Michael Wahl (Wissenschaftlicher Tagungsleiter) und Dr. Ronald Schnabel (VDE/VDI-Gesellschaft Mikroelektronik, Mikrosystem- und Feinwerktechnik / GMM). Weitere Informationen zu dieser GMM-Fachtagung und alle weiteren aktuellen Hinweise finden Sie im Internet unter www.AmE2015.de oder auch direkt unter <http://conference.vde.com/ame2015/Seiten/Startseite.aspx>

■ 8. AAL Kongress am 29. und 30. April 2015

Der 8. AAL Kongress geht neue Wege! Erstmals wird der Kongress in Frankfurt am Main gemeinsam mit der ‚Zukunft Lebensräume‘ an der Messe Frankfurt am 29. und 30. April 2015 veranstaltet. Unverändert ist die immense Bedeutung des Themas AAL für die großen gesellschaftlichen Herausforderungen, vor denen wir stehen. Wie können assistive Technologien ein selbstbestimmtes und aktives Leben der Menschen bis ins hohe Alter unterstützen? Der AAL-Kongress gibt Antworten auf diese Frage und stellt die Bereiche Wohnen, Gesundheit und Pflege in den Mittelpunkt. Zum 8. Mal werden sich Forscher, Entwickler, Hersteller, Dienstleister, Anwender, Nutzer sowie Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verbänden dazu interdisziplinär und fachübergreifend austauschen. Neueste wissenschaftliche Ergebnisse werden diskutiert und auf ihre Praxistauglichkeit geprüft. In der Fachaussstellung besteht die Möglichkeit sich über Produkte und Dienstleistungen konkret zu informieren. Und im Rahmen von Podiumsdiskussionen, Plenarvorträgen und Fachsessions werden auch übergeordnete Fragen etwa zur Technologieförderung oder zu Refinanzierungskonzepten in den Blick genommen. Durch die Partnerschaft mit der ‚Zukunft Lebensräume‘ kann der Schulterschluss zwischen Forschung, Entwicklung und Anwendung noch intensiver gestaltet werden. Nach wie vor werden den 8. AAL-Kongress die Pflege bestehender Kontakte und die Anbahnung neuer Kooperationen ebenso prägen wie Gespräche in angenehmer Atmosphäre.

Auf einen erfolgreichen Kongress und spannende Gespräche in Frankfurt freut sich

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Wolfgang Wahlster, Wissenschaftlicher Tagungsleiter

CEO des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI)

Veranstalter

Veranstalter ist der VDE (Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.), einer der großen europäischen Verbände für Branchen und Berufe der Elektro- und Informationstechnik. Eine internationale Experten-Plattform für Wissenschaft, Normung und Produktprüfung – interdisziplinär, eng verflochten, und einmalig auf der Welt. Eine geballte Konzentration an Erfahrung, Marktkenntnissen und technologischem Know-how.

Veranstaltungsort

Die Messe Frankfurt erschließt Ausstellern internationale Märkte für ihre Produkte. Als eines der weltweit führenden Messeunternehmen sind wir in mehr als 150 Ländern für unsere Kunden präsent. Als aufmerksamer Gastgeber kümmern wir uns vor, während und nach den Messen intensiv um unsere Aussteller, Besucher und Gäste – und zwar überall in der Welt.

Call for Papers

*Frist zur Beitragseinreichung
ist der 30. Oktober 2014!*

Der 8. AAL-Kongress fokussiert auf technische Hilfsmittel, die Menschen im Alltag und im Beruf unterstützen, ihre Gesundheit bewahren und fördern sowie Folgen von Krankheit und Verletzung mildern, kompensieren oder beheben. AAL zeichnen sich dadurch aus, dass unterschiedliche Technologien und technische Komponenten, z. B. Sensoren, Aktoren, oder Informations- und Kommunikationstechnologien derart in einem System integriert sind, dass der unterstützte Mensch das Assistenzsystem möglichst autonom verwenden und damit sicherer, gesünder und mit weniger körperlichen Einschränkungen am sozialen und beruflichen Leben teilhaben kann.

Der 8. AAL-Kongress fokussiert auf technische Assistenzsysteme mit Anwendung in den Bereichen Wohnen, Gesundheit und Pflege. Erbeten ist die Einreichung von Vortrags- oder Posterbeiträgen aus den folgenden AAL-Bereichen: Arbeit, Aus- und Weiter-

bildung, Bau und Installation, Gesundheit, Mobilität, Pflege, Produkte und Dienstleistungen, Quartierskonzepte, Technische Forschung, Teilhabe, Telemonitoring, Wohnen.

Eine detaillierte Darstellung der Themen und Schwerpunkte des Call for Papers findet sich in der Download-Box rechts.

Es bestehen zwei Möglichkeiten der Beitrags-einreichung:

1. Veröffentlichung deutschsprachiger Beiträge als CD mit ISBN-Nummer beim VDE Verlag:
 - Bis spätestens 30.10.2014 können deutschsprachige Abstracts (1 Seite pdf) eingereicht werden. Bis zum 16.01.2015 erfolgt eine Benachrichtigung, ob die Abstracts angenommen wurden. Bis spätestens 02.03.2015 müssen dann deutschsprachige Beiträge (6 bis 10 Seiten, Format pdf) eingereicht werden, die über den VDE-Verlag auf einem USB-Stick mit ISBN-Nummer veröffentlicht werden.
2. Veröffentlichung englischsprachiger Beiträge in einer Buchpublikation beim Springer Verlag:
 - Bis spätestens 30.10.2014 können englischsprachige Beiträge (6 bis 10 Seiten, Format pdf) eingereicht werden. Bis zum 16.01.2015 erfolgt eine Benachrichtigung, ob die Beiträge angenommen wurden. Bis spätestens 02.03.2015 besteht die Möglichkeit, die Beiträge vor der Veröffentlichung zu aktualisieren.

Bitte beachten Sie ferner:

1. Die Einreichung von Beiträgen erfolgt ausschließlich online über die Konferenz-Software ‚EDAS‘ (Download-Box auf der Webseite <http://conference.vde.com/AAL/Seiten/CallforPapers.aspx>).
2. Bei Einreichung muss seitens des Autors eine Auswahl getroffen werden, welche der beiden o. g. Publikationsformen angestrebt wird. Die Beiträge für die Buch-Publikation unterliegen einem gesonderten Review-Prozess.
3. Für beide Publikationsarten müssen entsprechende Schreibvorlagen verwendet werden (Download-Box rechts).
4. Bei Einreichung der Beiträge muss zudem eine Zuordnung zu den folgenden sechs Themen-

schwerpunkten erfolgen (siehe auch detaillierte Darstellung des Call for Papers in der Downloadbox rechts):

- Wohnen & Bauen, AAL & Energieeffizienz
- Quartierslösungen & regionale Versorgung
- Basistechnologien, Zukunft der Technik
- Soziale Teilhabe & Mobilität
- Mensch-Technik-Interaktion, ethische & soziale Fragen
- Sonstige

5. Beitragsautoren zahlen eine reduzierte Teilnahmegebühr von € 290,-.

Programm

Das Programm wird derzeit erarbeitet. Es wird mit über 150 Beiträgen als Vorträge, Poster und Podiumsdiskussionen gerechnet. Weitere Informationen folgen in Kürze.

Registrierung und Teilnahmegebühren

Die Möglichkeit zur Online-Registrierung wird in Kürze freigeschaltet.

Teilnahmegebühren

Die Tagungsgebühr beinhaltet den Tagungsband (USB-Stick), Kaffeepausen, Mittagspausen sowie das Get-Together am 29. 04. 2015.

Tab. 2: Anmeldung

	bis 28.2. 2015	ab 1.3. 2015
Teilnehmer/in	480 €	530 €
Teilnehmer/in (VDE-Mitglied)*	450 €	500 €
Hochschulangehörige/r	380 €	430 €
Hochschulangehörige/r (VDE-Mitglied)*	350 €	400 €
Student/in**	180 €	230 €
Studentin (VDE-Mitglied)*/**	150 €	200 €
Referenten (Call-for-Papers)	290 €	

*) Für persönliche VDE-Mitglieder. Angabe der Mitgliedsnummer erforderlich.

**) Limitiertes Kontingent. Bitte vorher bei der Tagungsorganisation anfragen. Vorlage des Studentenausweises erforderlich.

Bei Stornierung bis zum 27. März 2015 wird die Teilnahmegebühr abzüglich 50,- € für Bearbeitungskosten zurückerstattet (ausgenommen Referenten aus dem Call-for-Papers). Bei Stornierung nach diesem Zeitpunkt kann eine Rückerstattung der Teilnahmegebühr nicht mehr vorgenommen werden. Es ist jedoch möglich, einen Ersatzteilnehmer zu benennen.

Ausstellung

Die Ausstellung wird von unserem Partner Messe Frankfurt organisiert. Sie finden eine Übersicht zur Ausstellung in der Ausstellerinformation in der Box auf der rechten Seite. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte direkt an die Messe Frankfurt:

- *Petra Lutz*, Veranstaltungsmanagement, Telefon: +49 69 7575-5325, Fax: +49 69 7575-5727, petra.lutz@messefrankfurt.com
- *Annette Holtmann*, Ausstellerbetreuung, Telefon: +49 69 7575-3262, Fax: +49 69 7575-5727, annette.holtmann@messefrankfurt.com

Heat of the Matter

Das Chapter von IMAPS UK lädt am 23. Oktober 2014 zu einer speziell auf Belange der Hochtemperatur Elektronik zugeschnittenen Veranstaltung nach Oxford ein. Es sind Vorträge zu Themen wie Sensoren für Aerospace, Herausforderungen von nichtkeramischen Packages für 225 °C und Hochtemperatur-Flex PCB's auf dem Programm. Informationen zu Cu-Schaum, einigen Testmethoden sowie Interfacematerialien in HighRel-Applikationen runden das Programm ab.

Details zum Programm und zur Registrierung finden Sie unter <http://uk.imapseurope.org/index.php/event-calendar/details/42-HTM>

Die Proceedings

Die diesjährigen Seminars in Dresden zum Thema ‚Volumenintegration – Stapen, Falten, Vergraben‘, können auf CD zum Preis von 55 € erworben werden.

Die aktuelle CD-ROM enthält neben den 2014er-Proceedings auch die mehrerer früherer Herbst- und Frühjahrsveranstaltungen. Unsere Seminare sind traditionell themenorientiert und beschäftigten sich zuvor mit zu Themen wie ‚Medizintechnik – Herausforderungen an das Packaging‘, ‚Manche mögen's heiß – Power Electronic Packaging‘, oder ‚Ist Zuverlässigkeit noch bezahlbar?‘



Provisional Programme			
9.30am	Introductions and Exhibitor Presentations		
10am	Session 1: Application Needs		
Keynote	Ian Loader	Universal Science	"Keeping Cool!: Selecting High Performance Thermal Interface Materials"
Presentation 2	Steve Riches	GE Aviation	"High Temperature Sensor Conditioning and Processing in Aerospace Applications"
10.45am	Coffee Break		
11.15am	Session 2: Modelling & Design		
Presentation 3	Piers Tremlett	Microsemi	"The challenges of designing non ceramic packaging for 225C"
Presentation 4	Philip Johnston	Trackwise	"High Temperature Flex PCBs"
Short Presentations	Academic "elevator pitch" presentations and poster session.		
12.45pm	Lunch Break		
2pm	Session 3: Thermal Interface Materials		
Presentation 5	Graham Wilson	Indium Corporation	"Thermal Interface Materials in High Reliability Applications"
Presentation 6	TBC	Versarien	"Engineering Copper Foams for Advanced Heat Transfer Application"
2.45pm	Tea Break		
3.15pm	Session 4: TIMs Test Methods, Characterisation and Standards		
Presentation 7	David Saums	DS&A LLC	"Practical Aspects of Thermal Interface Material Testing Methods"
Presentation 8	Jiyu Xu	NPL	"Development of National Standard Facilities for Characterising Thermal Transport Properties of Interface Materials"
4pm	Best Poster Award, Thanks and Close		

Contact: Andy Longford - office@imaps.org.uk or 0131 202 9004

www.imaps.org.uk

Das voraussichtliche Programm von Heat of the Matter

■ Veranstaltungskalender

Ort	Zeitraum	Name	Veranstalter
München	23.-24. Okt. 2014	Herbstkonferenz 2014	IMAPS D
Oxford	23. Okt. 2014	„Heat of the Matter“	IMAPS UK
Dresden	20.-23. April 2015	CICMT 2015	DKG, ACerS, IMAPS
Friedrichshafen	13.-16. Sept. 2015	EMPC 2015	IMAPS Europa, IMAPS D

Ihre Bestellungen richten Sie bitte an:

Ernst Eggelaar, c/o Microtronic GmbH, Kleingrötzing, 84494 Neumarkt-St.Veit, Fax +49 8722 9620-30, ee@microtronic.de



Bitte beachten Sie, dass der angegebene Preis gemäß §4 Nr.22 UStG umsatzsteuerfrei ist und die verfügbare Anzahl begrenzt ist.

■ IMAPS Deutschland – Ihre Vereinigung für Aufbau- und Verbindungstechnik

IMAPS Deutschland, Teil der ‚International Microelectronics and Packaging Society‘ (IMAPS), stellt seit 1973 in Deutschland das Forum für alle dar, die sich mit Mikroelektronik und Aufbau- und Verbindungstechnik beschäftigen. Mit mehr als 300 Mit-

gliedern verfolgen wir im Wesentlichen drei wichtige Ziele:

- Wir verbinden Wissenschaft und Praxis
- Wir sorgen für den Informationsaustausch unter unseren Mitgliedern und
- Wir vertreten den Standpunkt unserer Mitglieder in internationalen Gremien.

■ Impressum

IMAPS Deutschland e.V.

1. Vorsitzender:

Prof. Dr.-Ing. Martin Schneider-Ramelow
Fraunhofer-Institut für Zuverlässigkeit und Mikrointegration (IZM)

Head of Dep.: System Integration
and Interconnection Technologies

Gustav-Meyer-Allee 25, 13355 Berlin

Tel +49 30 46403-172 (-270 Sekr., Fax -271)

martin.schneider-ramelow@izm.fraunhofer.de

www.izm.fraunhofer.de

Schatzmeister

(bei Fragen zu Mitgliedschaft und Beitrag):

Ernst G. M. Eggelaar, ee@microtronic.de



Ausführliche Kontaktinformationen zu den Vorstandsmitgliedern finden Sie unter www.imaps.de (Vorstand)